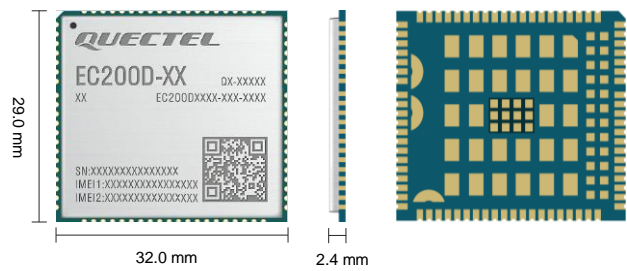


Quectel EC200D系列
物联网首选
LTE Cat 4模块



EC200D系列是移远通信专为M2M和IoT领域而设计的LTE Cat 4无线通信模块，包含EC200D-CN、EC200D-EU和EC200D-AU三个型号。采用3GPP Rel-12 LTE技术，支持最大下行速率150 Mbps和最大上行速率50 Mbps。同时，EC200D系列在封装上兼容移远通信多网络制式UMTS/HSPA+ UC200A-GL以及LTE Standard EC200x系列、EC2x系列和EG2x-G模块，实现了从3G网络向4G网络的轻松平滑过渡。

EC200D系列模块采用镭雕工艺，具有外观精美、金属质感强、散热更好、信息不容易被抹除、更能适应自动化需求等优点。

EC200D系列内置丰富的网络协议，集成多个工业标准接口，并支持多种驱动和软件功能（适用于Windows 10/11、Linux、Android 等操作系统下的USB驱动），极大地拓展了其在M2M领域的应用范围，如MiFi、OTT、CPE、路由器、数据卡、平板电脑、智能安全以及工业级PDA等。



主要优势

- ✓ 专为M2M和IoT应用而设计的LTE Cat 4无线通信模块
- ✓ 多网络制式覆盖
- ✓ 支持DFOTA功能
- ✓ MIMO技术满足无线通信系统对数据速率和连接可靠性的要求
- ✓ 支持QuecOpen®和QuecPython®方案
- ✓ 双卡双待单通

 LTE Cat 4 最大150 Mbps（下行） 最大50 Mbps（上行）	 最大21 Mbps（下行） 最大5.76 Mbps（上行）	 LCC 封装
 内嵌多种网络协议	 DFOTA	 VoLTE
 双卡双待单通	 USB 驱动	 移远通信增强型 AT命令

Quectel EC200D 系列

LTE Cat 4	EC200D-CN	EC200D-EU	EC200D-AU
区域/运营商	中国/印度	欧洲/亚太/非洲	澳大利亚/新西兰/拉丁美洲
模块尺寸（mm）	29.0 × 32.0 × 2.4	29.0 × 32.0 × 2.4	29.0 × 32.0 × 2.4
温度范围			
工作温度范围	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
扩展温度范围	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
频段信息			
LTE-FDD	B1/3/5/8	B1/3/5/7/8/20/28	B1/2/3/4/5/7/8/17/28/66
LTE-TDD	B34/38/39/40/41	B38/40/41	B40
WCDMA	B1/5/8	B1/5/8	B1/2/4/5/8
GSM/EDGE	-	可选，B3/8	B2/3/5/8
认证			
强制认证	中国：SRRC/NAL/CCC	欧洲：CE 澳大利亚/新西兰：RCM	-
其他认证	WHQL	WHQL	WHQL
最大数据传输速率			
LTE-FDD (Mbps)	150（下行）/ 50（上行）	150（下行）/ 50（上行）	150（下行）/ 50（上行）
LTE-TDD (Mbps)	130（下行）/ 30（上行）	130（下行）/ 30（上行）	130（下行）/ 30（上行）
HSDPA/HSUPA (Mbps)	21（下行）/ 5.76（上行）	21（下行）/ 5.76（上行）	21（下行）/ 5.76（上行）
WCDMA (kbps)	384（下行）/ 384（上行）	384（下行）/ 384（上行）	384（下行）/ 384（上行）
EDGE (kbps)	-	236.8（下行）/ 236.8（上行）	236.8（下行）/ 236.8（上行）
GSM (kbps)	-	85.6（下行）/ 85.6（上行）	85.6（下行）/ 85.6（上行）
接口			
(U)SIM	× 2	× 2	× 2
UART	× 3（主串口、调试串口、辅助串口）	× 3（主串口、调试串口、辅助串口）	× 3（主串口、调试串口、辅助串口）
USB 2.0	× 1	× 1	× 1
数字音频（PCM）	× 1	× 1	× 1
模拟音频	输入 × 2（麦克风） 输出 × 2（扬声器、听筒）	输入 × 2（麦克风） 输出 × 2（扬声器、听筒）	输入 × 2（麦克风） 输出 × 2（扬声器、听筒）
NET_STATUS	× 1	× 1	× 1
NET_MODE	× 1	× 1	× 1
ADC	× 2	× 2	× 2
SDIO	× 1（QuecOpen®方案：× 2）	× 1（QuecOpen®方案：× 2）	× 1（QuecOpen®方案：× 2）
RESET_N	× 1	× 1	× 1
PWRKEY	× 1	× 1	× 1
SPI	× 1（仅 QuecOpen®方案）	× 1（仅 QuecOpen®方案）	× 1（仅 QuecOpen®方案）
I2C	× 1，开发中（QuecOpen®方案：× 2）	× 2（仅 QuecOpen®方案）	× 2（仅 QuecOpen®方案）
矩阵键盘（5 × 5）	× 1（仅 QuecOpen®方案）	× 1（仅 QuecOpen®方案）	× 1（仅 QuecOpen®方案）
充电管理	× 1（仅 QuecOpen®方案）	× 1（仅 QuecOpen®方案）	× 1（仅 QuecOpen®方案）
天线接口	× 2（最多）：主天线、分集接收天线 ^①	× 2：主天线、分集接收天线	× 2：主天线、分集接收天线
音频			
语音编解码模式	HR/FR/EFR/AMR/AMR-WB	HR/FR/EFR/AMR/AMR-WB	HR/FR/EFR/AMR/AMR-WB
回声算法	回声消除/噪声抑制	回声消除/噪声抑制	回声消除/噪声抑制
语音	数字语音和 VoLTE（Voice over LTE）	数字语音和 VoLTE（Voice over LTE）	数字语音和 VoLTE（Voice over LTE）
突出特性			
双卡双待单通	●	●	●
DTMF*	●	●	●
DFOTA	●	●	●
音频回放/音频录制	●	●	●
QuecFile®	●	●	●
(U)SIM卡检测	●	●	●
软件特性			
协议栈	TCP/UDP/PPP/NITZ/PING/FILE/MQTT/NTP/HTTP/ HTTPS/SSL/FTP/FTPS/MMS/SMTP/SMTPS/CMUX	TCP/UDP/PPP/NITZ/PING/FILE/MQTT/NTP/HTTP/ HTTPS/SSL/FTP/FTPS/MMS/SMTP/SMTPS/CMUX	TCP/UDP/PPP/NITZ/PING/FILE/MQTT/NTP/HTTP/ HTTPS/SSL/FTP/FTPS/MMS/SMTP/SMTPS/CMUX
驱动	RIL	Android 4.x~14.x	Android 4.x~14.x
	USB 转串口	Windows 10/11 Linux 2.6~6.7 Android 4.x~14.x	Windows 10/11 Linux 2.6~6.7 Android 4.x~14.x
	USB RNDIS	Windows 10/11 Linux 2.6~6.7	Windows 10/11 Linux 2.6~6.7
	USB ECM	Linux 2.6~6.7	Linux 2.6~6.7
电气特性			
供电电压	3.4~4.5 V，典型值 3.8 V	3.4~4.5 V，典型值 3.8 V	3.4~4.5 V，典型值 3.8 V
功耗（典型值）	52 μA @ 关机 2.2 mA @ LTE 休眠（PF = 128） 1.5 mA @ LTE 休眠（PF = 256） 15.03 mA @ 空闲	54 μA @ 关机 2.43 mA @ LTE 休眠（PF = 128） 2.02 mA @ LTE 休眠（PF = 256） 14.76 mA @ 空闲	54 μA @ 关机 2.54 mA @ LTE 休眠（PF = 128） 2.09 mA @ LTE 休眠（PF = 256） 14.91 mA @ 空闲

备注：
1. *：正在开发中。
2. ①：EC200D-CN模块的分集接收天线可选。

3. ●：支持。
4. QuecOpen®方案详情，请咨询移远通信技术支持。

